

組立後の洗浄工程削減へ!

Eliminate cleaning process after assembly!

フラックス残渣レスペースト

Less flux residue paste

NP303-FLV-T4

フラックス残渣が残らず**洗浄不要!**

Since flux residue does not remain, cleaning is unnecessary!

Niなどのヌレにくい母材に対しても**ヌレ性良好!**

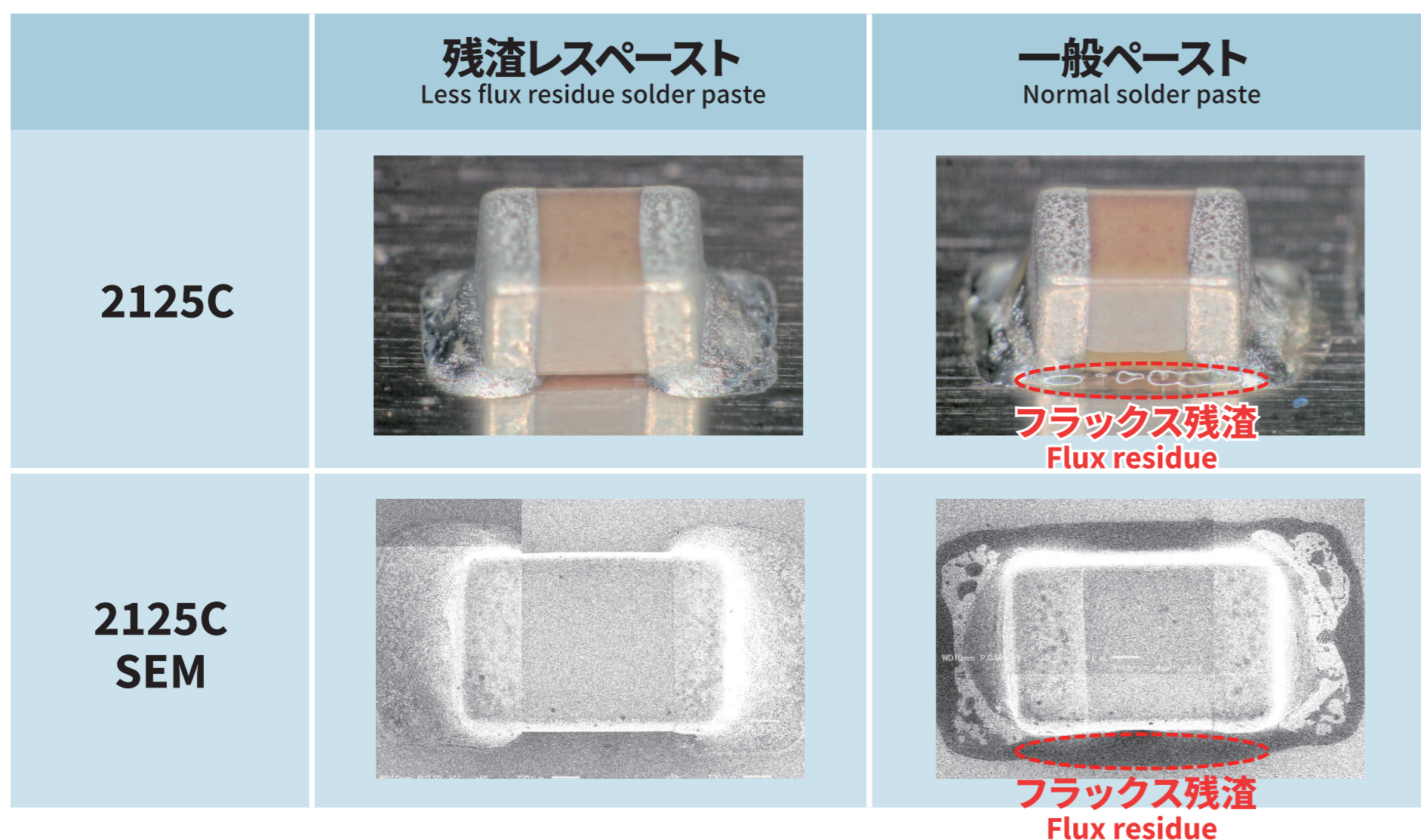
Wettability to the parts that are hard to be wet like Ni are also good!

N2+真空リフロー対応で**ボイド発生を抑制!**

Suppress occurrence of void by N2 + vacuum reflow furnace!

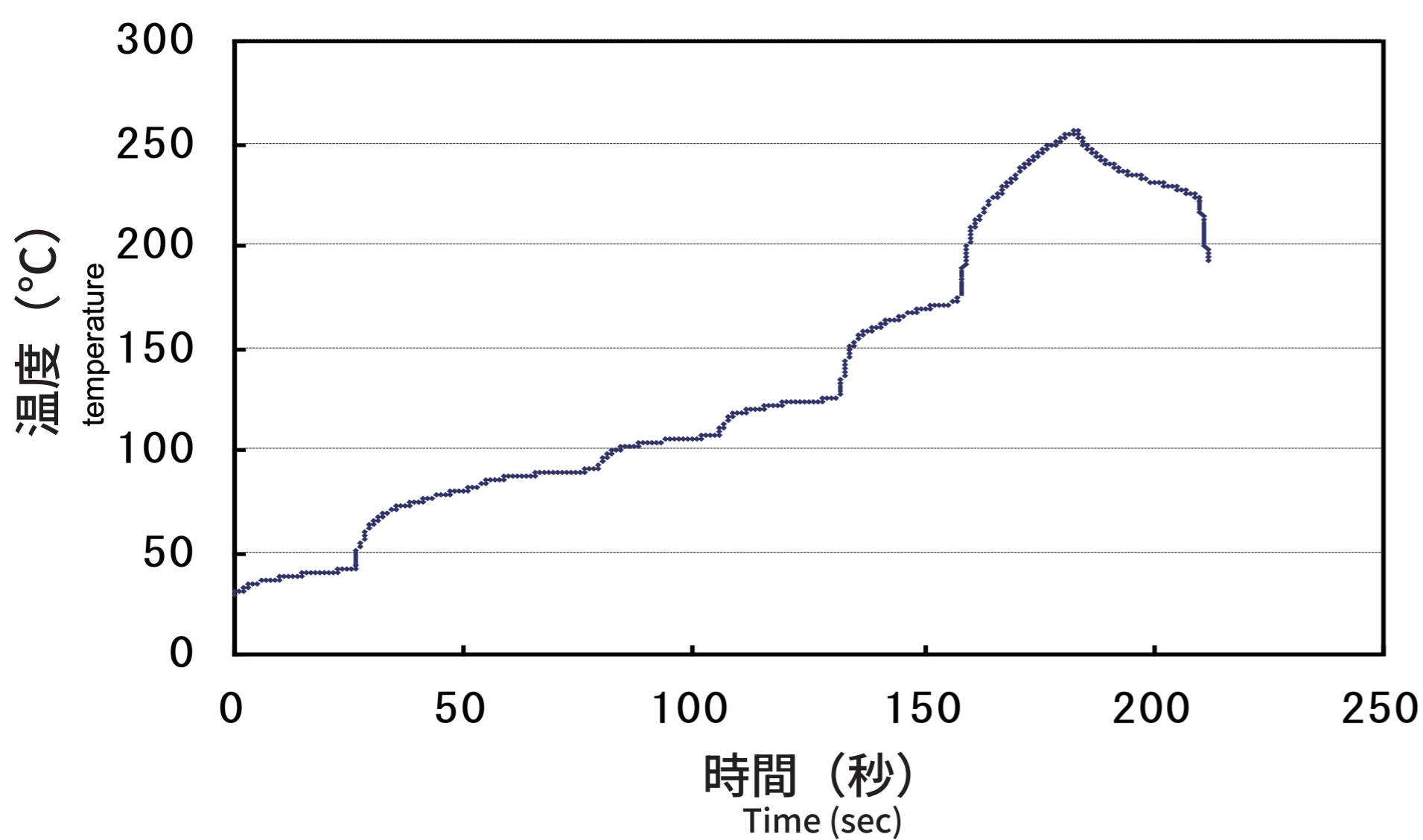
揮発によるフラックス残渣抑制

Suppression of flux residue by volatilization



推奨リフロープロファイル

Recommended reflow profile



	試験条件 Test condition	推奨条件 Recommended conditions
昇温速度 Temperature increase rate	1.0sec.	2sec.以下
プリヒート (100°C-170°C) Preheat	60.8sec.	40-70sec.
昇温速度 (170°C-220°C) Temperature increase rate	4.6°C/sec.	4°C/sec.以上
>220°C	46sec.	30-90sec.
ピーク温度 Peak temperature	260.6°C	250-270°C
酸素濃度 Oxygen concentration	500ppm	500ppm以下
真空到達度 Degree of vacuum	3.9kPa	10kPa以下

ギ酸リフロー対応

フラックス残渣レスペースト

Less flux residue paste applied for formic acid reflow

NP303-FL001-T4

ギ酸リフローにより**フラックス残渣、ボイドゼロ!**

No flux residue and void due to formic acid reflow!

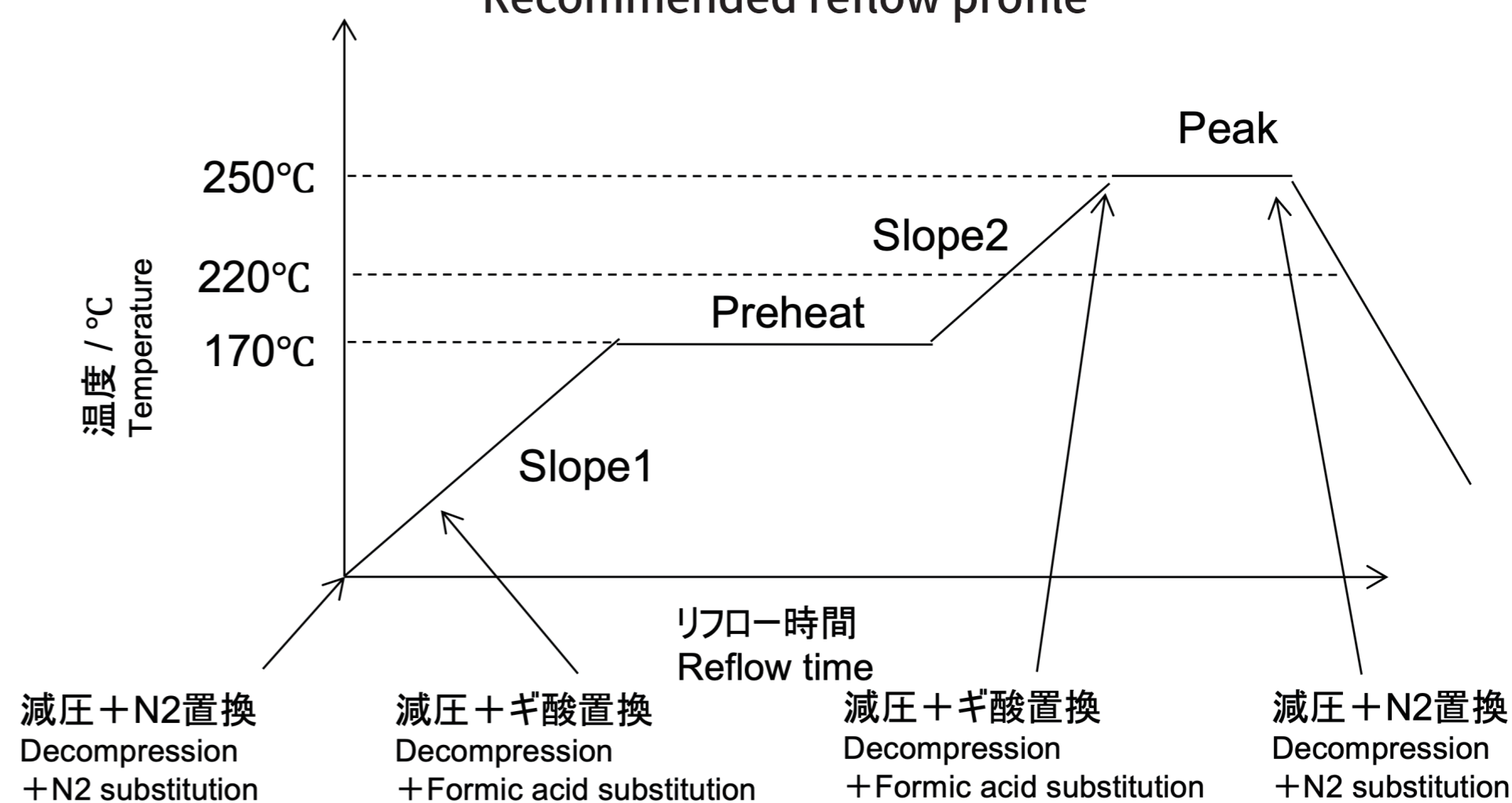
ギ酸リフロー性の検証結果

Test result of reflowability for Formic acid reflow

外観写真 Exterior Photograph	X線透過写真 X-ray Transmission Photograph	Cu板濡れ写真 Cu plate wetting photograph
ぬれ性良好 Good wettability フラックスの残留無 No flux residue	ボイド無 No void	フラックスの残留無 No flux residue

推奨リフロープロファイル

Recommended reflow profile



Step	条件 Conditions
Slope1, 2	2.0°C/sec以内 within 2.0°C/sec
Preheat	170°C、60sec以上 more than 170°C60sec
Peak	Sn3Ag0.5Cuの融点 (217°C)+15°C以上 melting point of Sn3Ag0.5Cu+ more than 15°C
220°C以上 (半田の融点以上) More than 220°C (more than melting point of solder)	30sec以上 more than 30sec
ギ酸導入のタイミング Supply timing of formic acid	Preheat前とPeak温度前に2回 Total of 2 times before preheat and peak temperature

